

## JDB917 透明双组分介电凝胶

### 产品描述

JDB917 是一种低粘度、透明双组分介电凝胶，兼具有优异的自修复性能和良好的电气绝缘性能，可有效提高元器件防潮、绝缘、抗振能力，其优良的耐高低温、耐候性能保证了元件的长期可靠性。同时也能提供应力消除，以保护电路和电感免受高温和机械应力。

### 产品特性

- 高透明，可自修复性；
- 良好介电特性；
- 耐老化，弹性和硬度永久保持；
- 可室温硬化，也可加热快速硬化；
- 对大部份基材保持压敏粘性；

### 产品用途

产品适用于大功率 IGBT 的保护灌封、电气/电子应用方面的保护以及其他电子器件的绝缘灌封。

### 主要性能

项目		典型值		测试标准
硬化前物性				
组分	--	A	B	--
外观	--	无色透明	无色透明	--
粘度 (23℃)	MPa·s	400±200	400±200	GB/T 15223-2008
比重 (23℃)	g/cm <sup>3</sup>	0.98±0.01	0.98±0.01	GB/T 13477.2-2002
重量比混合	A:B	1:1		GB/T 13477.2-2002
可操作时间 (25℃)	min	30~60		--
完全固化时间 (25℃)	h	2~4		--
硬化后性能				
针入度	100g	380±20		GB/T 269—91
介电强度	kV/mm	>1.5		GB/T 1408.1—2006
介电常数(1MHz)	--	2.8		GB/T 1693—200
损耗因素(1 MHz)	--	<0.001		
体积电阻率	Ω·cm	≥1.0×10 <sup>15</sup>		GB/T 1410—2006

工作温度	°C	-50~200	--
------	----	---------	----

### 使用说明

- 将A、B组分按1:1的重量比例称量，混合均匀，直接注入需灌封保护的元器件（或模块）中。
- 将灌封好的元件静置，可直接在室温条件下固化，自然消泡时间10~15min，自然凝胶时间约90min，完全固化时间大约需要3小时。

### 注意事项

- 使用前，请详细查阅MSDS。
- 温度过高会导致固化速度太快，建议环境恒温。
- 对混合后 AB 组分真空脱泡可提高硬化产品性能。
- A、B组分取用后应密封保存。
- JDB917与含硫、胺、锡材料接触会难以硬化。
- 为了避免上述现象，胶液灌封使用前，应尽量擦干净器件上面残留的松香，尽量使用低铅含量的焊锡。

### 包装规格

20 公斤/套(A 组分:10Kg / 桶 ;B 组分:10Kg / 桶)

### 储存及运输

- 远离儿童存放，保持产品避光和避热，并且密封保存。
- 在 28° C 或低于该温度未开封保存时，产品自生产之日起保质期为 6 个月。
- 本产品为非危险品，按一般化学品贮存、运输。

### 我们能为您提供哪些帮助？

请告知我们您的性能、设计和制造问题。我们将利用我们的硅基物料专知，敷涂知识和加工经验为您提供服务。